

证券代码：688332

证券简称：中科蓝讯

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-022

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称	信达澳亚基金、亚太汇金基金、海南宽行私募基金、西南证券、东方财富证券
时间	2025年9月22日至9月25日
地点	深圳市中科蓝讯科技股份有限公司大会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书：张仕兵 董事会办公室主任：曹卉 证券事务代表：刘懿瑶
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司简介：</p> <p>中科蓝讯主营业务为无线音频 SoC 芯片的研发、设计与销售，公司正逐步形成以蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片、智能穿戴芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片、玩具语音芯片、AIoT 芯片、AI 语音识别芯片、Wi-Fi 芯片、视频芯片十大产品线为主的产品架构，产品可广泛运用于 TWS 蓝牙耳机、智能音箱、智能可穿戴设备、无线麦克风、智能玩具、物联网设备等无线互联终端。目前产品已进入小米、OPPO、realme 真我、荣耀亲选、万魔、飞利浦、倍思、漫步者、Anker、铁三角、传音、魅蓝、FIIL、弱水时砂、IKF、sanag、boAt、Noise、TITAN、NOKIA、腾讯 QQ 音乐、百度、喜马拉雅、科大讯飞、博雅 BOYA 等终端品牌供应体系。</p>

公司已披露《2025年半年度报告》，2025年上半年，公司实现营业收入81,175.30万元，较上年同期增长2.63%；归属于母公司所有者的净利润13,112.43万元，较上年同期减少2.61%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润11,068.15万元，较上年同期减少1.14%。

问答环节：

1、公司二季度收入、利润环比均有较大改善，尤其是净利润，环比接近翻倍，请总结上半年公司经营情况及二季度大幅改善的原因？

答：公司上半年营业收入情况符合行业淡旺季消费趋势，每年的一、二季度为消费淡季，且全球消费环境由于美国关税、中东战争等因素，对公司出货有一定影响；此外，由于公司产品所面向的主要市场为全球消费电子下沉市场，国内以旧换新和国补政策对于全球市场的需求拉动并不明显。但公司也在加大研发和市场投入，以多元化、均衡的客户及产品组合应对全球市场结构化调整。公司推出新产品BT897X、BT891X、AB573X芯片，凭借出色的性能表现和优异的性价比，获得了全球众多客户的青睐。同时，公司持续注重成本和费用的管控，盈利能力持续改善。二季度公司实现销售收入44,445.05万元，环比一季度增长21%，净利润8,623.41万元，环比一季度增长92.10%，扣非后净利润7,400.97万元，环比一季度增长101.82%。

2、近期摩尔线程上会审议，沐曦股份回复了第二轮问询，请介绍公司投资摩尔线程、沐曦股份和燧原科技的具体情况。

答：为强化公司在半导体核心领域的战略布局并赋能长期发展，公司基于对行业趋势的深度研判与严格筛选机制，围绕GPU、AI及先进封装测试等高成长性领域，进行了前瞻性投资布局。其中，公司直接持有沐曦集成电路（上海）股份有限公司85.43万股，占

其首次公开发行前总股本的 0.24%；公司直接持有摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司 134.04 万股，占其首次公开发行前总股本的 0.34%，通过北京启创科信创业投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有摩尔线程智能科技（北京）股份 67.01 万股，占其首次公开发行前总股本的 0.17%，合计为 0.50%；公司通过蔚蓝（深圳）私募创业投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有上海燧原科技股份有限公司 89.71 万股，持股比例为 0.23%。

3、请介绍公司在 AI 端侧方面的布局。

答：自去年 11 月，公司讯龙三代芯片 BT895X 平台完成了与火山方舟 MaaS 平台的对接，向用户提供适配豆包大模型的软、硬件解决方案，并搭载于 FIIL GS Links AI 高音质开放式耳机后，公司与火山引擎正持续、分阶段开展合作。今年 5 月，公司携基于 AB6003G Wi-Fi 芯片的 AI 玩具方案亮相 2025 火山引擎 FORCE 原动力大会，AB6003G 是集 Wi-Fi+蓝牙+音频，三合一的高性能 SoC，为物联网场景提供更高性能及用户体验的解决方案，可广泛应用于智能家居、智能穿戴、工业物联网、智慧城市等多个领域，助力实现设备之间的无缝连接与数据交互。未来，公司将持续布局 AI 端侧领域，继续与国内外大模型平台开展合作，向市场推出用户体验度更好的 AI 端侧产品解决方案。

4、请介绍公司 Wi-Fi 产品线的情况。

答：6 月 11 日，公司携基于中科蓝讯 AB6003G Wi-Fi 芯片的 AI 玩具方案亮相 2025 火山引擎 FORCE 原动力大会和由百度智能云、汕头市澄海区人民政府主办的 2025AI 玩具产业创新和发展会议，AB6003G 是集 Wi-Fi+蓝牙+音频，三合一的高性能 SoC，可广泛应用于智能家居、智能穿戴、工业物联网、智慧城市等多个领域，助力实现设备之间的无缝连接与数据交互。

后续,公司 Wi-Fi 芯片的应用场景将重点围绕音视频及 AI 功能拓展,如 AI 智能音箱、AI 智能玩具等方向,搭载上述芯片的终端产品也会陆续推向市场。

5、公司在智能音箱芯片和无线麦克风芯片等新品类上的进展如何?

答:2025 年,公司推出了基于 BT896X 的 LE Audio 方案,特别是 Auracast 技术,可满足后续中高阶音箱的市场。量产了多款飞利浦等品牌的高阶 Soundbar 产品,通过 BT896X 的强大算力,实现了高阶 Soundbar 的蓝牙 SoC 单芯片解决方案。公司还配合荣耀亲选推出 Honor Ikarao BT Speaker mini 音箱,音质音效指标优异,产品受到了行业更多的用户群体的关注和认可。此外,公司基于新品 Wi-Fi 芯片,后续也将推出 Wi-Fi 智能音箱等产品的解决方案。

在无线麦克风芯片方面,公司持续以 BT891X、AB566X 等系列等适配不同的市场需求,提升市占比,在领夹麦克风市场也持续耕耘,完成了无线麦克风从高阶到中阶到入门级的全方面产品梯队技术建立。同时,公司突破了品牌客户,已有数个基于公司方案的品牌产品量产,搭载公司 AB5712F 芯片的 BOYA Magic 真 AI 降噪变形麦克风已于近期发布。

6、公司突破品牌客户的进展如何?

答:公司借助于 BT 系列芯片前期积累的行业口碑,更多的耳机、专业音频品牌客户与公司达成了长期深度的合作模式,2025 上半年推出的 OnePlus Bullets Wireless Z3, realme T200, Nothing CMF Buds 2a, 荣耀亲选耳机 GEG X7e 等均搭载了公司 BT893X 系列芯片。同时,2025 上半年,公司推出多款新品,借助于极高的性能表现,获得国内外客户青睐:BT897X 系列芯片,支持浮点运算,基础功耗优化到 4mA 级别,音频指标也提升到行业领先水平,同时,通过加入 NPU 单元,极大地提升了芯片对 AI 通话算法的运算能力,

降低了通话时的功耗，目前已搭载于 FIIL Key Pro2 入耳式 Hybrid ANC 蓝牙耳机、弱水时砂琉璃 MK2 真无线降噪蓝牙耳机、倍思 BS1 NC 半入耳主动降噪耳机，后续会配合更多行业先进客户的耳机项目；BT891X 系列芯片：超低功耗、旗舰级音频指标，适配品牌入门级产品，已搭载于多款耳机、无线麦克风产品中，下半年将有更多新品逐步推出。

2025 年，公司正式开启“两个连接”新篇章，公司 Wi-Fi 技术成功落地，推出集 Wi-Fi+蓝牙+音频三合一的高性能的 AB6003G 芯片，并在 2025 火山引擎 FORCE 原动力大会以及由百度智能云、汕头市澄海区人民政府主办的 2025 AI 玩具产业创新和发展会议进行了展出。

随着公司芯片产品的不断丰富，可以适应品牌从入门级到中高阶产品的差异化功能需求，有助于公司不断提升市场竞争力和持续经营能力，有望在更多的终端品牌客户中获得运用。

7、公司毛利率情况如何？

答：公司加大研发投入，持续产品升级与优化，推出多款高毛利产品以及对现有产品升级迭代，可以适应品牌从入门级到中高阶产品的差异化功能需求以及下沉市场的超高性价比需求，不断提升市场份额。同时，公司与上游各供应商均建立了长期、稳定的深度合作关系，将根据市场变化及公司销售策略合理管控库存，以应对下游市场需求增长和新产品备货需求，公司将持续合理安排供应商采购活动，继续深化合作，确保产能稳定、成本可控，使公司毛利率保持在合理水平。

8、公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？

答：公司将围绕“AI 赋能、技术领先、产品多元、市场全球化”的战略定位，持续加大研发投入，保持在低功耗、高音质、高集成度音频芯片等核心技术领域的领先地位，同时为适应未来产品多元

	<p>化发展，公司积极布局 Wi-Fi 和视频芯片领域，加快视频技术的落地，聚焦 AI 耳机、音箱、眼镜、玩具等应用场景。公司的产品线也将由原来的八大产品线拓展到包含蓝牙耳机芯片、智能音箱芯片、智能穿戴设备芯片、无线麦克风芯片、数字音频芯片、AIoT 芯片、智能玩具芯片、AI 语音芯片、Wi-Fi 芯片、视频芯片在内的十大产品线。与此同时，公司将继续深化与国内外头部客户的合作，扩大海内外市场份额，提升品牌影响力。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 9 月 26 日